

入 札 結 果 表

案件名称	電池材料界面構造解析用コンピュータの購入契約				
入札形式	一般競争入札				
入札日時	平成30年8月20日(月)午後2時00分から				
履行場所	地方独立行政法人大阪産業技術研究所				
契約期間	平成30年11月16日(金)(納入期限)				
入札結果	落札	備考			
落札業者名	HPCシステムズ株式会社				
契約金額	¥2,997,000(消費税及び地方消費税相当額を含む)				
予定価格	¥2,775,000(消費税及び地方消費税相当額を除く)				
最低制限価格又は 低入札調査価格	¥ — (消費税及び地方消費税相当額を除く) ※設定していない場合は「—」とする。				
No	業 者 名 称	入札金額(税抜き)			摘要
		1回目	2回目	3回目	
1	HPCシステムズ株式会社	¥2,775,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
備 考					